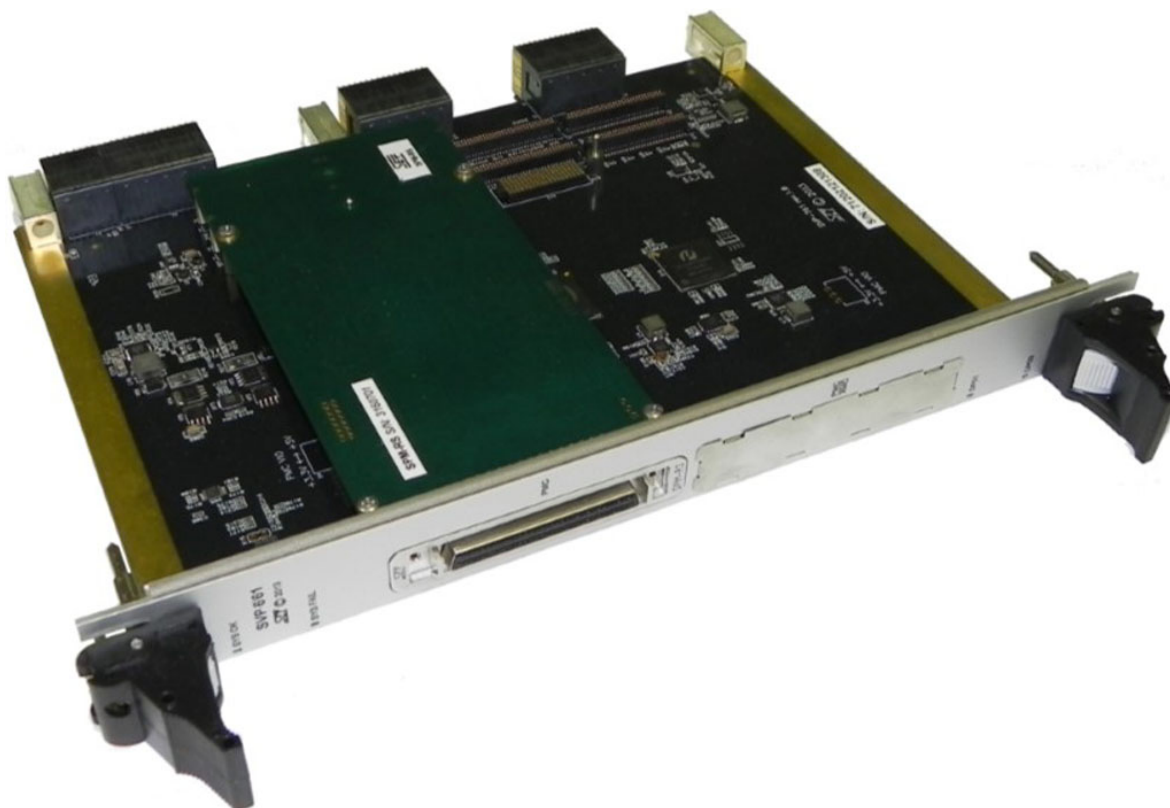


SVP-661

Несущий модуль для 2-х submodule PMC
и 1-го XMC форм-фактора VPX 6U



Основные особенности

- Установка двух submodule PMC, одного submodule XMC
- Интерфейс PCI Express 2.0 x4 через VPX FP
- Модуль форм-фактора VPX 6U, соответствующий стандартам: ANSI/VITA 46.0-2013 (воздушное охлаждение), ANSI/VITA 46.4-2012, ANSI/VITA 46.9-2010 и ANSI/VITA 65-2010 (R2012)
- Поддержка интерфейсов PCI/PCI-X до 64 бит, 133 МГц для PMC

Обзор модуля

Особенности

Модуль SVP-661 — несущая плата конструктива VPX в форм-факторе 6U с гибкими коммутационными возможностями и с широким диапазоном рабочих температур. Модуль SVP-661 соответствует стандартам VPX: ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard, ANSI/VITA 46.4-2012 PCI Express on the VPX Fabric Connector, ANSI/VITA 46.9-2010 PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules Standard и ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard и позволяет встраивать в систему широкую гамму готовых submodule PMC единичной или двойной ширины.

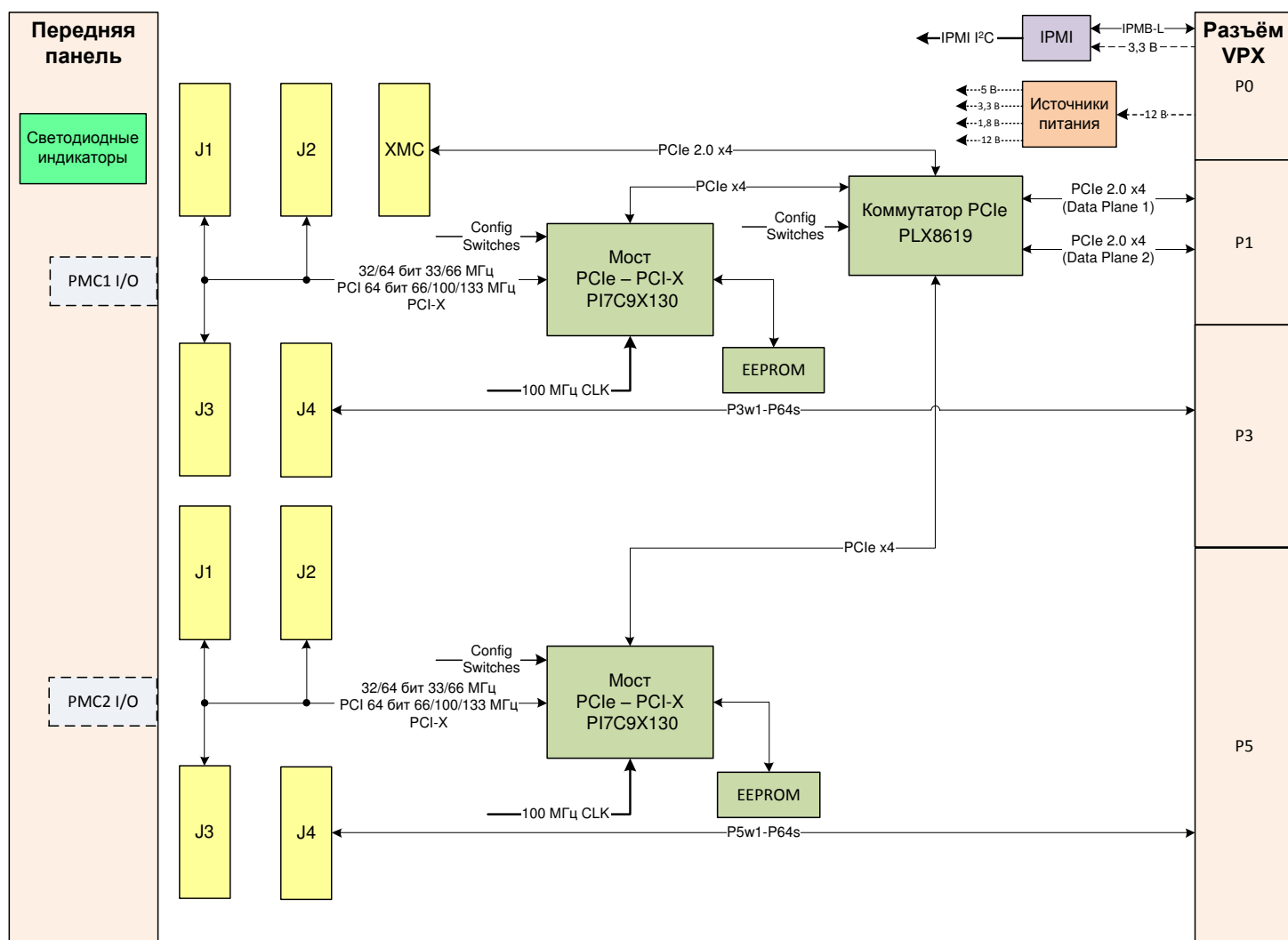
Для модулей PMC реализуется любой параллельный интерфейс PCI, включая PCI-X 64 бит/133 МГц. Для модулей PMC выведены I/O в соответствии с стандартом ANSI/VITA 46.9 VPX: ANSI/VITA 46.9-2010 PMC/XMC Rear I/O Fabric Signal Mapping on 3U and 6U VPX Modules Standard.

Области применения

Модуль SVP-661 позволяет встраивать в VPX систему широкую гамму готовых submodule XMC/PMC единичной ширины.

Несущая плата предназначена для создания систем сбора и цифровой обработки сигналов, встраиваемых в приборы, либо на базе промышленных компьютеров, соответствующих стандарту ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard.

Функциональная блок-схема



Технические характеристики

Интерфейсные контроллеры

2 × мост PCIe-PCI Pericom PL7C9X130: преобразование PCI Express x4 в PCI-X 64 бит/133 МГц к субмодулям PMC

Коммутатор PLX8619: коммутация 2 × PCI Express x4 от разъёма VPX к мосту PCI Express-PCI (PCI Express x4)

Субмодули

Поддержка установки субмодуля PMC: 2 × PMC: шина PCI-X 64 бит/133 МГц (индивидуально для каждого субмодуля)

Поддержка установки субмодуля XMC: 1 × XMC: шина PCI Express 2.0 x4

Система мониторинга и управления IPMI

Автоматическое отключение питания при возникновении серьезных сбоев на модуле

Мониторинг температур и напряжений питания модуля

Ведение журнала учета отказов блоков системы

Возможность удаленного контроля и управления модулем

Возможность «горячего» обновления и восстановления программного обеспечения IPMI без нарушения работы модуля

Поддержка «горячей замены» (Hot Swap)

Соответствие стандартам

ANSI/VITA 46.0-2013 VPX Base Standard

ANSI/VITA 46.4-2012 PCI Express on the VPX Fabric Connector

ANSI/VITA 46.6-2013 Gigabit Ethernet Control Plane on VPX

ANSI/VITA 65-2010 (R2012) OpenVPX System Standard

IPMI v. 1.5 с поддержкой служебных функций

Разъёмы VPX

Разъём P0:

- сигналы IPMB-L.

Разъём P1:

- 2 × PCI Express x4 через пластины 1–4 и 5–8.

Разъём P3:

- сигналы I/O субмодуля PMC 1.

Разъём P5:

- сигналы I/O субмодуля PMC 2.

Энергопотребление

Потребляемая мощность несущего модуля не более 80 Вт

Распределение потребляемой мощности по линиям питания:

- +12 В (VS1/VS2): до 6,5 А (79 Вт);
- +3,3 В_AUX до 0,1 А (0,33 Вт).

Условия эксплуатации

Охлаждение: воздушное

Диапазон рабочих температур: коммерческий (0...+50 °С) или промышленный (-40...+85 °С)

Температура хранения: -50...+100 °С

Влажность: 10–95 % без конденсата

Возможность нанесения влагозащитного покрытия для жёстких условий

Размеры

Форм-фактор: VPX 6U

Размеры: 160 × 233 × 25,06 мм

Информация для заказа

Возможна поставка модуля в другом температурном диапазоне по согласованию.

**I**

Исполнение (температурный диапазон)

T0: Коммерческое (0...+50 °C)

T1: Индустриальное (-40...+85 °C)

II

Покрытие

CV0: Без влагозащитного покрытия

CV1: С влагозащитным покрытием

III

Охлаждение

CL0: Воздушное

CL1: Кондуктивное

Пример кода изделия: **SVP-661-T1-CV1-CL1**

SVP-661 — Несущий модуль для 2-х submodule PMS и 1-го XMC форм-фактора VPX 6U

Исполнение (температурный диапазон): Индустриальное (-40...+85 °C)

Покрытие: С влагозащитным покрытием

Охлаждение: Кондуктивное

Возможны другие конфигурации модуля по индивидуальному запросу. За дополнительной информацией обращайтесь в SET.

Контактная информация



ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком»
Россия, 394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 75
Тел.: +7 (473) 272-71-01, факс.: +7 (473) 251-21-99
www.setdsp.ru

Электронная почта:
Отдел продаж: sales@setdsp.ru

ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб»
Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., д. 3, корп. 1, лит. М.
Тел.: +7 (812) 406-99-95, +7 (812) 406-99-96
www.setdsp.ru

Электронная почта:
Отдел продаж: sales.spb@setdsp.ru

ЗАО «Скан Инжиниринг Телеком». Все права защищены. © 1991–2018
Документ DS-SVP-661 1.1 создан в ООО «Скан Инжиниринг Телеком - СПб». Все права защищены. © 2018